

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 奈良安雄 副委員長 大野裕三

幹事 笹子佳孝 幹事補佐 黒田理人

日時 2月28日(金) 9:25~16:25

会場 機械振興会館地下3階研修1号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. [http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map\\_kaikan.htm](http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm) TEL {03} 3434-8211)

議題 配線・実装技術と関連材料技術

1. [招待講演] 大口径中性粒子ビーム CVD を用いた ULK-SiOCH 膜  
○寒川誠二(東北大)・菊池良幸(東北大/東京エレクトロン)
2. [招待講演] 先端 Low-k 配線技術における課題と指針 井上尚也(ルネサス)
3. [招待講演] 三次元積層向けウェハの裏面研削によるダメージ評価  
○水島賢子(富士通研/東工大)・金 永ソク(東工大/デイスコ)・中村友二(富士通研)・杉江隆一・橋本秀樹(東レリサーチセンター)・上殿明良(筑波大)・大場隆之(東工大)
4. [招待講演] TSV の高速形成に向けた有機系導電インクの注入手法 川喜多 仁(物材研)

午後

5. [基調講演] 集積回路のこれから 益 一哉(東工大)
6. [招待講演] インプラント法によるカーボンナノチューブプラグの作製とスパッタアニール法による多層グラフェン配線との接合 ○佐藤元伸・高橋 慎・二瓶瑞久・佐藤信太郎・横山直樹(産総研)
7. [招待講演] 導電性下地上でのカーボンナノチューブの低温・稠密成長  
○野田 優(早大)・羅 ヌリ(早大/東大)・白井 聖・野村桂甫(東大)・長谷川 馨(早大)
8. [招待講演] 気相堆積重合ポリイミドを用いた TSV ライナー形成  
○福島誉史・マリアッパン ムルゲサン・裴 志哲・李 康旭・小柳光正(東北大)
9. [招待講演] デバイス積層応用に向けた低温超音波フリップチップ接合形成技術による 15 $\mu\text{m}$  ピッチ微細 Cu/Au 接続 ○青柳昌宏・Thanh-Tung Bui・加藤史樹・渡辺直也・根本俊介・菊地克弥(産総研)

◆応用物理学会共催